Produktdatenblatt

Spezifikationen



Modicon M580S HSBY-Safety-CPU-Modul, 6040 Level 6 DIO+RIO, 64 MB, 61 Eth-Geräte, 31 Remote-E/A-Racks (X80 & Quantum E/A)

BMEH586040S

EAN Code: 3606489562533

Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M580
Produkt- oder Komponententyp	Redundante Prozessormodule
Imprägnierungsmaterial	Schutzbeschichtet

Zusatzmerkmale

Anzahl von Racks	1
anwendungspezifischer E/A	Zähler Motion Control SSI-Encoder Genaue Zeitstempelung Serielle Schnittstelle HART
Prüfungen	Prozesssteuerung Sicherheitssteuerung (Safety)
Steuerkanäle	Programmierbare Regelkreise
Integrierte Verbindungsart	1 Ethernet TCP/IP für Service-Port 2 Ethernet TCP/IP für Gerätenetzwerk USB Typ Mini-B 1 Ethernet für HSBY-Port
Anzahl entfernter E/A-Stationen	31 - 2 Einbaugehäuse pro X80 und Quantumabfall
Anzahl verteilter Geräte	61,0
Kapazität des Kommunikationsbaustein-Prozessors	4,0 Ethernet-Kommunikationsmodul 16 AS-Interface-Modul
Kommunikationsdienst	DIO-Scanner RIO-Scanner
Speicherbeschreibung	Erweiterbar Flash, 4 GB für Datenspeicherung Integriert RAM, 10 KB für Systemspeicher Integriert RAM, 64 MB für Programm und Daten Integriert RAM, 16 MB für Programmsicherheit Integriert RAM, 1.024 kB für Datensicherheit
Anwendungsstruktur	1 Master Task 1 periodische Fast Task 1 periodische sichere Task
Cybersicherheit	Achilles-zertifiziert DoS-Abwehr IPSec SNMP-Logging Syslog-Protokollunterstützung Autit Trail (logging) Integrierte Firewall Firmware-Signatur Passwortschutz Härtung Sicherheitsprotokoll

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl der Anweisungen pro ms	40 kAnw/ms 65% boolesch + 35% fest-arithmetisch 50 Kinst/ms 100 % boolesch
Stromaufnahme	360 mA bei 24 V DC
MTBF Zuverlässigkeit	650000 H
Beschriftung	CE

Montage

Vibrationsfestigkeit	3 Gn
Stoßfestigkeit	15 Gn
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C
Betriebshöhe	0 - 2.000 m 2.000 - 5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor
Relative Luftfeuchtigkeit	5…95 % bei 55 °C Betauung nicht zulässig
Schutzart (IP)	IP20
Richtlinien	2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/42/EC - Maschinenrichtlinie 2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
Produktzertifizierungen	CE UL CSA RCM EAC Handelsmarine ATEX Zone 2/22 IECEx Zone 2/22 TÜV UKCA
Normen	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, Schnittstelle Typ 1 und Typ 2 EN/IEC 61850-3, Standort G IEC 60079-0 EN 50155 EN 50121-3-2 EN 50121-4 EN 50121-5 EN 45545-2 IEC 60571 IEC 62236-3-2 IEC 62234-4 IEC 62234-5
Umgebungseigenschaften	Gefahrenbereich Klasse I Division 2 Gasbeständig Klasse Gx entspricht ISA S71.04 Gasbeständig Klasse 3C4 entspricht IEC 60721-3-3 Staubbeständig Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3 Sandbeständigkeit Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3 Salzbeständig Level 2 entspricht IEC 68252 Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3 Pilzsporen-resistent Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3
Beschichtung	Schutzlackierung
Sicherheitsniveau	SIL 3 entspricht IEC 61508 SIL 3 entspricht IEC 61511 SILCL 3 entspricht IEC 62061 SILCL 3 entspricht ISO 13849-1 Kategorie 4 SIL 4 entspricht EN 50126 SIL 4 entspricht EN 50128 SIL 4 entspricht EN 50129

Versorgung	Interne Stromversorgung über Modulträger
LED-Statusanzeige	1 LED (grün) Prozessor in Betrieb (RUN) 1 LED (rot) Prozessor- oder Systemfehler (ERR) 1 LED (rot) I/O Modulfehler (I/O) 1 LED (grün) Downloadvorgang aktiv (DL) 1 LED (rot) Speicherkarten- oder CPU-Flash-Fehler (BACKUP) 1 LED (grün/rot) ETH MS (Konfigurationsstatus Ethernet-Schnittstellen) 1 LED (grün/rot) Eth NS (Ethernet-Netzwerkstatus) 1 LED (grün) Peer-Prozessor in Betrieb (REMOTE RUN) 1 LED (grün) Prozessor-ID Satz bis A (A) 1 LED (grün) Prozessor-ID Satz bis B (B) 1 LED (grün) Prozessor primär (PRIM) 1 LED (grün) Prozessor Standby (STBY) 1 LED (rot) E/A-Werte durch Nutzer überschrieben (FORCED IO) 1 LED (grün) Prozessor im Sicherheitsmodus (SRUN) 1 LED (grün) Prozessor im Wartungsmodus (SMOD) 1 LED (grün) Hot-Standby-Verbindungsstatus (HSBY Diag)
Produktgewicht	0,849 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,500 cm
VPE 1 Breite	17,500 cm
VPE 1 Länge	25,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	894,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,800 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**287 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**66 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**221 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

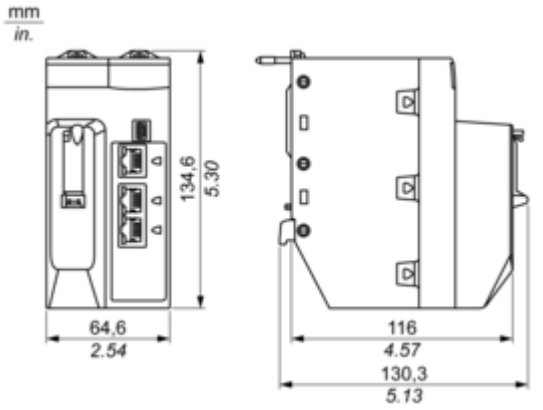
Use Again

Reproduktion

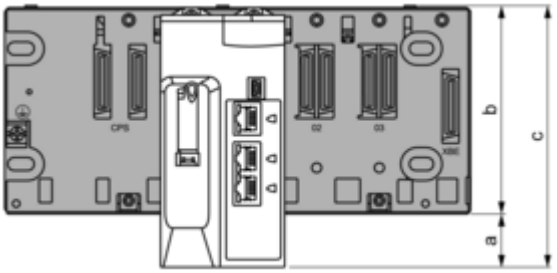
Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Nur CPU-Module

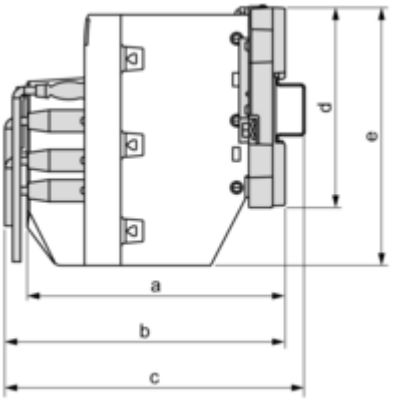


Auf Racks montierte Module



a: Zusätzlicher Abstand unter dem Rack zur Berücksichtigung der Höhe der CPU. X Bus-Rack: Der Abstand beträgt 30,9 mm (1.217 in.)Ethernet-Rack: Der Abstand beträgt 29,49 mm (1.161 in.)
b: Die Höhe des Racks. Für ein X Bus-Rack beträgt die Höhe 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack beträgt die Höhe 105,11 mm (4.138 in.).
c: Die Höhe des lokalen Hauptracks, 134,6 mm (5.299 in.)

In ein Gehäuse montierte Module und Kabel



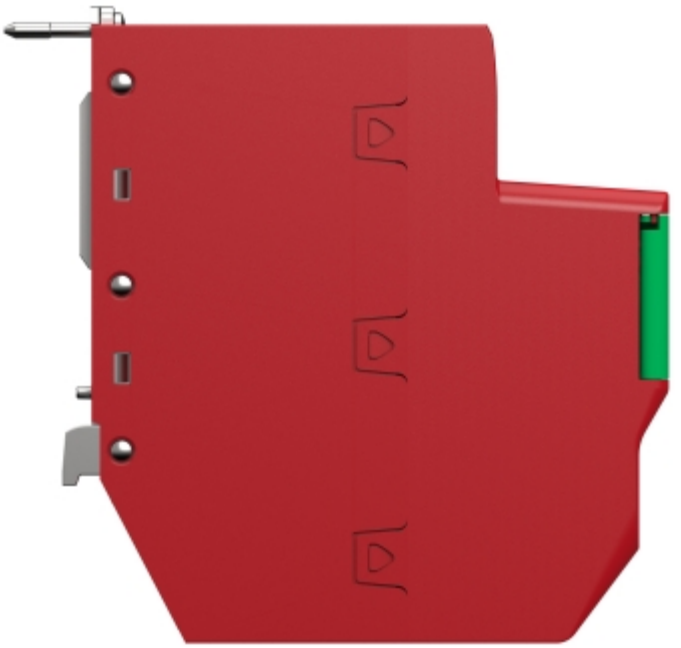
a: Gehäusetiefe: 135 mm (5.315 in.)
b: Tiefe Verdrahtung + Modul: > 146 mm (5.748 in.)
c: Verdrahtung + Modul + DIN-Schienentiefe: > 156 mm (6.142 in.)
d: Rackhöhe: X Bus-Rack 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack, 105,11 mm (4.138 in.)
e: Modulhöhe: 134,6 mm (5.299 in.)

Image of product / Alternate images

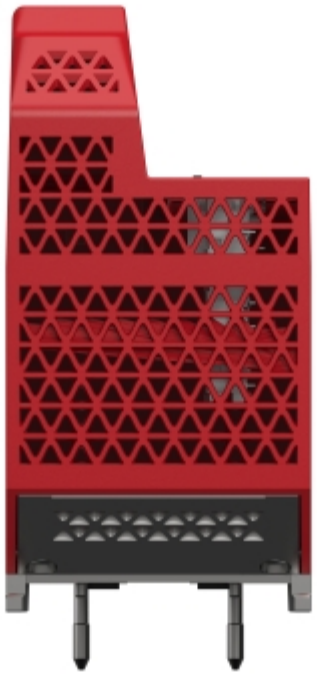
Alternative












M580
Service
Dual port
Device Network
Hsby Link
Hsby Diag